



SOP28パッケージ製品の供給終了について

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、現在貴社にご採用いただいております製品につきまして、後工程製造委託先においてパッケージ部材の調達が不可能になること、ならびに製造ライン老朽化に伴い製造ラインを廃止する通知を受けております。  
今後の供給については、下記の通りEOL生産、出荷となりますので、ご理解をいただけますようよろしくお願いいたします。

敬具

－ 記 －

1. 対象製品

MB85R256FPNF-G-JNE2 (SOP28パッケージ)  
MB85R256FPNF-G-JNERE2 (SOP28パッケージ)

2. 最終発注、出荷

貴社：最終発注：2022年 3月 31日 迄  
弊社：最終出荷：2022年 9月 30日 迄

3. 供給終了理由

SOP28パッケージ構成部材であるリードフレームと封止樹脂につきまして、2022年3月をもちまして生産終了とする、部材メーカーの判断がなされました。  
加えて、後工程製造委託先におけるSOP28製造ラインにおいては設備老朽化が進行し、既に装置寿命に達していることより、生産を継続するためには新規装置の配備を行なう製造ライン全面改修が必要とされましたが、委託先におけるSOP28の需要は縮小傾向にあるため、改修を実施しない判断がなされました。  
これを受けて、製造委託先を変更する継続生産の検討を進めてまいりましたが、SOP28製造を新規且つ少量生産数に対応いただける委託先がありませんでした。  
従いまして継続製造が困難となったため、製品供給を終了させていただきます。  
誠に申し訳ございませんが、状況をご理解いただきご了承いただけますよう、よろしくお願いいたします。

4. 添付資料

PTN-SM2109\_SOP28EOL説明資料

<連絡先>

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社  
営業統括部 第一営業部  
部長 野呂 幸一  
Email : noro.kouichi@fujitsu.com

以上